

---

证券代码：688352

证券简称：颀中科技



合肥颀中科技股份有限公司

Hefei Chipmore Technology Co.,Ltd.

（安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路2350号）

关于本次募集资金投向属于  
科技创新领域的说明

二〇二五年三月

## 合肥颀中科技股份有限公司

### 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“颀中科技”或“公司”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关规定，结合公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）方案及实际情况，对本次发行募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《合肥颀中科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”），具体内容如下：

#### 一、公司的主营业务

公司自设立以来，一直从事集成电路的先进封装和测试服务。公司秉持“以技术创新为核心驱动力”的研发理念，通过近二十年的研发积累和技术攻关，在凸块制造、测试以及后段封装环节上掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术和大量工艺经验，相关技术适用于显示驱动芯片、电源管理芯片、射频前端芯片等不同种类的产品，可以满足客户高性能、高品质、高可靠性封装测试需求。

在集成电路凸块制造领域，公司以金凸块为起点相继研发出“微细间距金凸块高可靠性制造技术”、“大尺寸高平坦化电镀技术”等核心技术，在提高预制图形高结合力、提升电镀环节稳定性等方面具有核心竞争力。近年来，公司的研发创新不局限于原有的金凸块上，在铜柱凸块、铜镍金凸块、锡凸块等其他凸块制造方面也取得了行业领先的研发成果。以铜镍金凸块为例，公司是目前境内少数可大规模量产铜镍金凸块的企业，开发出了“低应力凸块下金属层技术”、“微间距线圈环绕凸块制造技术”、“高介电层加工技术”等核心技术，可在较低成本下有效提升电源管理芯片等产品的性能；同时扩展了铜镍金凸块的应用，开发出了“显示驱动芯片铜镍金凸块制造技术”，在满足性能需求的基础上，为显示驱动芯片封装提供了更多解决方案。

在集成电路测试领域，公司具有以“测试核心配件设计技术”、“集成电路

测试自动化系统”为代表的测试技术，可以满足客户多品种、个性化、高自动化的测试需求。

在集成电路封装领域，公司以 COF、COG/COP 等显示驱动芯片封装技术为抓手，拥有“高精度高密度内引脚接合”、“125mm 大版面覆晶封装”、“全方位高效能散热解决技术”、“高稳定性晶圆研磨切割”等关键技术。针对非显示类芯片的 DPS 封装工艺，公司研发出“高精高稳定性新型半导体材料晶圆切割技术”，在可切割晶圆的精度、厚度、材质等方面进行了创新。针对非显示类芯片覆晶封装 FCQFN/FCLGA 封装工艺，公司研发出“高精密覆晶方形扁平无引脚及模块之封测的技术”，可以实现大尺寸基板的量产制造，提高了材料效率和生产效率。基于先进封装上的深厚积累，公司针对功率器件积极布局了前段晶圆正面金属（FSM，Front-Side Metallization）、背面减薄及金属化（BGBM，Back-Side Grinding and Back-side Metallization）工艺以及后段铜片夹扣键合（Cu Clip）封装工艺，以满足功率器件大电流、低导通阻抗的特性。

## 二、本次募集资金投向方案

本次发行的募集资金总额不超过人民币 85,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                          | 投资总额      | 拟投入募集资金金额 |
|----|-------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | 高脚数微尺寸凸块封装及测试项目               | 41,945.30 | 41,900.00 |
| 2  | 顾中科技（苏州）有限公司先进功率及倒装芯片封测技术改造项目 | 43,166.12 | 43,100.00 |
| 合计 |                               | 85,111.42 | 85,000.00 |

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施的重要性、紧迫性等实际情况先行投入自有或自筹资金，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，经公司股东大会授权，公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金

用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

## 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

### （一）高脚数微尺寸凸块封装及测试项目

#### 1、项目基本情况

本项目实施主体为合肥顾中科技股份有限公司，建设地点位于安徽省合肥市，项目建设期为 24 个月。本项目拟通过对合肥现有厂房进行改造，通过建造新的洁净车间、引进新的先进生产线，进一步扩充显示驱动芯片封装测试整体产能，完善铜镍金 Bumping 工艺布局，满足应用市场对显示类芯片封测的最新需求，整体提升公司在相关产品方面的竞争力。

#### 2、项目实施的必要性

##### （1）抓住市场增长机会，扩大显示芯片封装产能

显示芯片封测行业正迎来重要发展机遇。2024 年全球显示驱动芯片封测市场规模同比增长 6.0%，其中中国大陆市场规模达 76.5 亿元，同比增长 7.0%，增速高于全球水平。预计到 2028 年全球市场规模将达到 32.4 亿美元，中国大陆市场将保持 4%以上的稳定增长。

市场需求增长主要来自三个方面：首先是智能手机、平板电脑等消费电子的持续升级。根据赛迪统计，智能手机在显示面板下游终端出货量中占比最大，超过 50%。特别是 AMOLED 渗透率的持续提升，带动了对高性能显示驱动芯片的需求。其次是大尺寸显示市场的结构性变化，预计到 2026 年，65 英寸及以上的面板占比将达 38.65%，超高清户外大屏出货量也有明显增长。随着分辨率的提升，单台设备所需的显示驱动芯片数量显著增加，如 4K 电视需要 10-12 颗显示驱动芯片，8K 电视更需要 20 颗。第三是新兴应用领域的快速扩张。车载显示、智能穿戴、虚拟现实等新兴领域对显示技术提出了更高要求，不仅需

要更高的分辨率和刷新率，还需要更灵活的显示形态，这些都为显示驱动芯片封测带来新的市场机会。

为抓住市场机遇，巩固行业地位，公司拟通过本项目新增 Bumping、CP、COG、COF 等关键工艺的生产能力，显著提升公司在显示驱动芯片封测领域的市场竞争力。

## **(2) 技术创新与成本优化并重，提升市场竞争力**

显示驱动芯片封测行业正面临重要的技术发展机遇。金凸块作为主流封装材料，在电性能、可靠性和工艺成熟度方面具备显著优势，是高端显示驱动芯片封装的重要技术选择。但随着下游应用市场的不断扩大，特别是在消费电子领域，市场对更具性价比的封装解决方案需求日益增长。铜镍金(CuNiAu)凸块技术通过在铜基底上镀覆镍层和薄金层的结构设计，在满足此类市场需求的同时实现了成本的有效控制，为显示驱动芯片封装提供了新的技术选择。

从技术布局来看，发展多元化的封装技术路线，能够更好地满足不同细分市场的需求。金凸块技术将继续发挥其性能优势，而铜镍金凸块技术则可以满足对成本更为敏感的应用领域需求。这种差异化的技术布局有助于企业更好地服务不同类型的客户，扩大市场覆盖范围。

本项目将布局铜镍金凸块工艺产线，形成多元化的技术服务能力。通过优化产品结构和成本结构，增强公司在不同细分市场的竞争优势。通过全面的技术布局将帮助公司把握市场机遇，为未来持续发展奠定坚实基础。

## **(3) 把握产业转移机遇，强化本土配套能力**

显示产业正加速向中国大陆转移，带动了产业链本土化配套需求的快速增长。2024 年中国大陆 LCD 面板产能达 2.16 亿平方米，全球占比达到 77.4%；AMOLED 面板产能达 1,607 万平方米，全球占比达到 38.0%且预计 2028 年将提升至 44.4%。随着中国面板产业的快速发展和产能的持续扩张，上游显示驱动芯片封测的本土化配套需求日益迫切。

产业转移带来的市场机遇主要体现在三个方面：首先，中国大陆面板厂商

在全球的市场份额持续提升，带动了对本土配套的需求。其次，国际贸易环境的变化推动了产业链的重构，促使更多国际客户寻求中国大陆的封测产能。第三，国家持续加大对集成电路产业的支持力度，为行业发展创造了有利环境。在此背景下，国内显示驱动芯片封测企业迎来了难得的发展机遇。

本项目通过扩大显示驱动芯片封测产能，将帮助公司更好地把握产业转移机遇。一方面可以更好地满足快速增长的国内市场需求，为中国大陆面板产业提供更好的配套服务；另一方面通过引进先进工艺设备并持续提升技术能力，进一步增强在显示芯片封装领域的自主可控能力，降低对境外产能的依赖程度，提升供应链的稳定性和韧性。这不仅有利于公司的可持续发展，也将为国内显示产业链的完善提供重要支撑。

#### **（4）优化生产效率，降低成本并提升核心竞争力**

随着显示芯片封装市场的快速发展，生产效率的提升已成为行业领先企业保持竞争优势的重要因素，提升生产效率、优化资源配置已成为公司扩展产能、提升竞争力的关键。

通过本项目，公司将引入更为先进的自动化生产设备和智能化管理系统。在生产设备方面，将新增先进的高精度封装设备，提升生产的自动化水平，减少人工干预带来的不确定性。在生产管理方面，将通过智能化系统实现生产过程的实时监控和精细化管理，优化生产排程，提高设备利用率。这些升级将帮助公司在保证产品质量的同时，显著提升生产效率，缩短产品交付周期。

此外，自动化和智能化水平的提升还将带来显著的成本优势。通过减少人工成本、提高材料利用率、降低能源消耗等方式，优化公司的成本结构。预计项目实施后，公司的生产效率将获得显著提升，单位产品的生产成本将进一步降低，这将为公司未来的持续盈利和市场扩展奠定坚实基础。

### **3、项目可行性分析**

#### **（1）行业发展趋势和政策支持为本项目提供有利的外部环境**

整体来看，显示驱动芯片封测行业发展趋势向好。一方面，下游显示面板

产业持续升级，不断涌现出超大尺寸、高刷新率、柔性显示等新技术和新产品，为封测行业带来广阔市场空间。另一方面，显示驱动芯片在 AI、VR/AR、车载显示等新兴领域的应用不断深化，推动了封测技术的持续创新。

在产业政策方面，集成电路产业得到国家持续支持。2020 年 7 月国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》提到集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，从财税、投融资、研究开发等八大方面对助力集成电路企业的发展。同时，新型显示产业的发展规划也为显示驱动芯片封测带来机遇。2024 年 1 月发布的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》明确提出突破 Micro-LED 等显示技术并实现规模化应用。此外，2022 年工信部等五部门联合发布的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026 年)》要求推进 4K 以上新型微显示器件的规模量产，开发配套显示驱动芯片。

在区域发展环境方面，合肥作为“集成电路、新型显示、人工智能等三大国家级战新产业集群”，在土地、税收、融资等方面为集成电路企业和新型显示产业链公司提供了优惠政策。同时，当地完善的产业配套体系和丰富的人才资源，也为项目实施创造了良好条件。这些有利的政策环境和区域优势，将有力支持本项目的顺利实施。

## **(2) 深厚的技术积累和持续的创新能力为项目实施提供技术保障**

公司深耕显示驱动芯片封装测试领域多年，形成了以凸块制造、覆晶封装和测试为核心的完整技术体系。在凸块制造环节，公司已成功掌握金凸块和铜镍金凸块两大主流技术路线。在传统金凸块工艺方面，自主研发的“微细间距金凸块高可靠性制造技术”和“大尺寸高平坦化电镀技术”解决了显示驱动芯片高密度 I/O 制造的关键难题，提高了金凸块与芯片的结合力，显著提升了电镀工艺的稳定性。在铜镍金凸块技术领域，公司开发出“显示驱动芯片铜镍金凸块制造技术”，为显示驱动芯片封装提供了更具成本优势的解决方案，目前公司是境内少数实现显示驱动芯片铜镍金凸块规模化量产的企业，工艺良率已达到与金凸块相当的水平。

在后段封装环节，公司开发的 COG/COF 封装技术体系针对性解决了显示驱动芯片的技术痛点。“高精度高密度内引脚接合技术”实现了芯片与基板的高精度对位，有效提升了封装可靠性；“125mm 大版面覆晶封装技术”则大幅提高了单片基板的封装密度，显著提升了生产效率。公司还开发出“全方位高效能散热解决技术”，有效解决了高性能显示驱动芯片在工作过程中的发热问题。

在测试环节，公司自主开发的“测试核心配件设计技术”和“集成电路测试自动化系统”形成了完整的测试解决方案。这套系统不仅能满足不同客户的个性化测试需求，还实现了测试过程的高度自动化，大幅提升了测试效率和准确性。

公司持续加大研发投入，截至 2024 年 12 月末已取得 127 项授权专利，其中发明专利 60 项。这些技术创新成果得到了行业的广泛认可，公司先后被授予“江苏省覆晶封装工程技术研究中心”、“江苏省智能制造示范车间”、“江苏省企业技术研发机构”等荣誉称号。

本项目计划新增的 Bumping、CP、COG 和 COF 产能，将依托公司现有的成熟技术体系，特别是在铜镍金凸块方面的技术储备，有效增强公司的市场竞争力。公司完整的技术体系将确保新增产能能够快速达产并保持稳定的良率水平。

### **(3) 公司丰富的客户资源保障本项目新增产能顺利消化**

公司凭借领先的技术实力和稳定的产品质量，在显示驱动芯片封测领域积累了大量优质客户资源。在境外客户方面，公司与联咏科技、奇景光电、瑞鼎科技、敦泰电子、谱瑞科技等国际知名显示驱动芯片设计公司建立了长期稳定的合作关系。这些客户在全球显示驱动芯片市场占据重要地位。在境内客户方面，公司长期服务了集创北方、奕斯伟计算、格科微、云英谷、豪威科技、通锐微等快速成长的本土企业，随着国产替代进程加快，这些本土企业的市场份额持续提升。

公司与主要客户的合作关系建立在严格的供应商认证基础上。显示驱动芯

片封测供应商的认证周期通常需要 12-18 个月，认证内容涵盖技术能力、质量控制、产能规模、交付能力等多个方面。一旦通过认证并开始批量供货，客户基于产品质量稳定性和供应链安全的考虑，通常不会轻易更换供应商。目前公司已通过多家国际知名客户的质量体系认证，并持续获得客户的积极认可。

公司采取“客户优先”的服务战略，建立了专业的客户服务团队。在新产品导入阶段，公司技术团队提前介入客户的产品开发过程，协助客户优化产品设计，缩短产品开发周期。在量产阶段，公司能够根据客户需求快速调整生产计划，确保及时交付。这种深度合作模式显著增强了客户粘性，多家重要客户已与公司建立了战略合作关系，并获得客户广泛赞誉。公司正在积极开发新的客户资源，目前已有多家潜在客户进入认证阶段，未来将进一步扩大客户群体，为产能消化提供更广阔的市场空间。

稳定的客户合作关系和良好的市场口碑，丰富的客户资源和持续增长的市场需求，将为本项目新增产能的顺利消化提供有力保障。

#### **（4）数十年行业积累和稳定的管理团队是项目实施的重要支撑**

公司深耕集成电路封装测试行业数十年，在显示驱动芯片封测领域积累了丰富的运营管理经验。通过多年的实践和探索，公司建立了一套完整的生产运营管理体系，涵盖从产品研发、生产制造到品质管控的全流程。特别是在产能扩充项目管理方面，公司已成功完成多次重大产线建设，积累了丰富的项目实施经验。本项目将延续公司成熟的项目管理模式，确保项目如期达产。

在质量管理体系方面，公司通过了 ISO9001 质量管理体系、IATF16949 汽车行业质量管理体系等多项国际认证。目前公司在 Bumping、CP、COG/COF 等各主要环节的良率均高于行业平均水平。公司还开发并实施了 MES（制造执行系统）等现代化信息管理系统，实现了生产过程的实时监控和精细化管理，为大规模产能扩充奠定了管理基础。

公司核心管理团队保持高度稳定，多位高管在显示驱动芯片封测领域拥有 15 年以上从业经验。通过实施员工持股计划等长效激励机制，公司建立了一支

专业能力突出、执行力强的运营团队。稳定的管理团队和完善的管理体系，将有效保障本项目的顺利实施。

#### **4、项目备案、环评事项及进展情况**

截至本报告出具之日，本项目已完成项目备案手续（项目代码：2501-340163-04-02-801207）；环评手续正在办理中。

### **（二）顾中科技（苏州）有限公司先进功率及倒装芯片封测技术改造项目**

#### **1、项目基本情况**

本项目实施主体为顾中科技（苏州）有限公司，建设地点位于江苏省苏州市，项目建设期为 21 个月。本项目拟通过在现有的生产车间及办公区域内构建本项目所需的生产、办公等其他生产辅助配套空间，引进、购置一批先进的生产配套设施，提升非显类芯片的封装测试产能，完善公司非显示类芯片全制程的服务能力。

#### **2、项目必要性分析**

##### **（1）提升我国集成电路先进封装产业发展质量**

近年来，随着我国社会经济稳步提升以及科学技术飞速发展，产业链上游的芯片设计产业凭借其高附加值特性加速成长，有力地推动了下游集成电路封装测试行业的发展。与此同时，中国大陆集成电路制造领域呈现出蓬勃发展的态势，这进一步为下游封测行业的进步注入了强劲动力。据中国半导体行业协会发布的统计数据显示，2024 年中国大陆集成电路封装测试行业的销售规模达到 3,146 亿元，增速为 7.3%，但目前中国大陆传统封装占比相对较高。在集成电路制程不断向更高精度发展的背景下，单位面积 IO 端口数持续提升，先进封装作为延续和拓展摩尔定律的关键手段，无疑将成为未来集成电路实现高质量发展的重要方向。

本项目旨在完善公司在非显示类芯片封测全制程技术，新增产能全部属于先进封装与测试范畴，该项目的实施将为我国集成电路行业提供更为先进、全

面的封装测试服务，助力国内集成电路产业在先进封装领域实现突破，提升整体产业竞争力，推动行业向高端化迈进，在全球集成电路产业竞争格局中占据更有利的地位。

## （二）完善非显示类芯片封测制程

依托于在显示驱动芯片封测业务多年来的积累，公司于 2015 年进入非显示类芯片封测领域。经过多年的发展，公司非显示类芯片封测业务收入占比总体呈现出上升趋势，2024 年度占比约 8%，但与行业内的头部企业相比，公司非显示类芯片封测业务的总体规模仍然较小。

在制程方面，目前公司非显示类芯片封测业务主要集中于非全制程，业务收入主要来源于凸块制造和晶圆测试环节。反观长电科技、通富微电、华天科技等境内综合类封测企业，它们主要以全制程封测业务为主，相比之下，公司在综合竞争力方面略显不足。

本项目通过引进业内先进设备，在扩充非显示芯片 CP 环节，DPS 封装工序产能的同时，新导入了 BGBM/FSM、Cu Clip 和覆晶封装制程，这一系列举措使公司成功构建起完善的全制程封测技术体系，极大地提升了公司在非显示类芯片封测领域的市场竞争实力，为后续业务的进一步拓展与市场份额的提升奠定了坚实基础。

## （三）扩大下游应用领域，扩充公司业务版图

当前，集成电路行业正处于蓬勃发展深刻变革的关键时期。在全球范围内，受益于物联网、人工智能、5G 等新兴科技的迅猛发展，集成电路市场规模持续扩张。在此背景下，非显示业务是公司未来优化产品结构、实现营收增长与推动战略发展的关键着力点。公司凭借在显示驱动芯片封测领域积累的深厚技术优势，积极将业务拓展至其他先进封装领域。始终秉持专注细分领域的核心战略，公司大力发展以电源管理芯片、射频前端芯片为代表的非显示类芯片封测业务，同时本项目将新增功率器件封装布局，拓展新能源等大功率应用领域。

在战略布局上，公司精准锁定特定细分领域，以此为主轴开展业务。这一策略既能有效规避市场的激烈竞争，又能使公司将有限资源高效投入到具有广

阔市场前景的先进封测技术研发中。同时，公司持续加大在新材料、新终端应用等方面的研发投入，不断延伸技术产品线，致力于构建全制程的封测服务体系，逐步向价值链高端攀升。

通过上述举措，公司积极扩充业务版图，坚定不移地朝着综合类集成电路先进封装测试企业的目标大步迈进，力求在集成电路产业中占据更为重要的地位，实现可持续的高质量发展。

### 3、项目可行性分析

#### （一）行业发展趋势和政策支持为本项目提供有利的外部环境

集成电路封测行业正迎来重要的发展机遇期。在“后摩尔时代”，先进封装已成为提升芯片性能的关键途径。根据赛迪统计，2024 年全球先进封装测试业市场规模占整体的比例达 44.9%，未来随着传统芯片制程缩小面临物理极限，先进封装技术成为提升芯片整体性能和功能的重要选择，市场规模占比将继续增加。

在政策层面，国家持续加大对集成电路产业的支持力度。2020 年 7 月国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》提到集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，从财税、投融资、研究开发等八大方面对助力集成电路企业的发展。各地方政府也相继出台配套政策，江苏省发布《江苏省人民政府关于进一步促进集成电路产业高质量发展的若干政策》，在产业创新方面提供专项资金支持、政府采购支持、现金奖励支持等；在产业链整体水平方面提供培育招引产业链领航企业、省级专项资金重点支持、数字化转型支持等；在财税金融方面提供财政资金支持、税收优惠、信贷投放支持、融资担保等；在人才引进方面提供高层次人才引进、高校学科专业建设、紧缺人才培养等支持；在发展环境方面提供用地保障、产业供应链顺畅、长三角协同创新、营造良好营商环境等支持。

#### （二）公司先进封装技术成熟，为项目实施奠定坚实基础

通过多年的积累，公司在集成电路先进封装领域取得了多项核心技术，具有丰富的技术储备。在非显示驱动芯片封测领域，公司围绕铜镍金凸块、铜柱

凸块、锡凸块等领域开发出“低应力凸块下金属层技术”、“微间距线圈环绕凸块制造技术”、“高厚度光阻涂布技术”、“真空落球技术”等多项核心技术。具体而言，作为大陆地区少数实现铜镍金凸块量产的企业，公司可通过多层金属与介电材质的堆叠，在不改变芯片内部结构的情况下，优化后段封装形式，大幅提升芯片产品性能；在铜柱凸块、锡凸块技术上，公司也实现了较多的技术积累，实现了从凸块制造到后段封装的全制程扇入型晶圆级芯片尺寸封装（Fan-in WLCSP）技术，并已成功导入客户实现量产。该技术可实现封装后芯片尺寸基本等同于封装前尺寸，并降低封装成本，是未来先进封装的主流形式之一。

在测试环节，公司自主开发的“测试核心配件设计技术”和“集成电路测试自动化系统”形成了完整的测试解决方案。这套系统不仅能满足不同客户的个性化测试需求，还实现了测试过程的高度自动化，大幅提升了测试效率和准确性。

在封装环节，针对非显示类芯片的 DPS 封装工艺，公司研发出“高精高稳定性新型半导体材料晶圆切割技术”，在可切割晶圆的精度、厚度、材质等方面进行了创新。针对覆晶封装 FCQFN/FCLGA 封装工艺，公司研发出“高精密覆晶方形扁平无引脚及模块之封测的技术”，可以实现大尺寸基板的量产制造，提高了材料效率和生产效率。

以上的技术储备与本项目的定位高度契合。项目新增的 BGBM/FSM、Cu Clip、覆晶封装制程将依托现有非显示类芯片封测技术和工艺积累，完善公司全制程封测技术。公司成熟的技术工艺和研发积累为本项目的顺利实施提供坚实基础。

### （三）下游客户的积极认可为本项目新增产品提供销售保证

公司凭借领先的技术实力和稳定的产品质量，在非显示驱动芯片封测领域积累了大量优质客户资源。在客户方面，公司与矽力杰、杰华特、南芯半导体、艾为电子、唯捷创芯、希荻微电子等国内知名非显示类芯片设计公司建立了长期稳定的合作关系。

公司与主要客户的合作关系建立在严格的供应商认证基础上。成为合格的非显示类芯片封测供应商除了较长的认证周期外还包括多类产品认证内容，认证内容涵盖技术能力、质量控制、产能规模、交付能力等多个方面。一旦通过认证并开始批量供货，客户基于产品质量稳定性和供应链安全的考虑，通常不会轻易更换供应商。目前公司已通过多家国际知名客户的质量体系认证，并持续获得客户的积极认可。

公司采取“客户优先”的服务战略，建立了专业的客户服务团队。在新产品导入阶段，公司技术团队提前介入客户的产品开发过程，协助客户优化产品设计，缩短产品开发周期。在量产阶段，公司能够根据客户需求快速调整生产计划，确保及时交付。这种深度合作模式显著增强了客户粘性，多家重要客户已与公司建立了战略合作关系，并获得客户广泛赞誉。公司正在积极开发新的客户资源，目前已有多家潜在客户进入认证阶段，未来将进一步扩大客户群体，为产能消化提供更广阔的市场空间。

丰富的客户资源和持续增长的市场需求，将为本项目新增晶圆级载带产能的顺利消化提供有力保障。此外，下游客户对公司产品质量的高度认可，为公司新增的功率器件、覆晶封装封测产品的成功销售提供了基础保证。

#### **4、项目备案、环评事项及进展情况**

截至本报告出具之日，本项目已完成项目备案手续（备案证号：苏园行审技备〔2025〕109号）；环评手续正在办理中。

### **三、本次募集资金投资属于科技创新领域的主营业务的说明**

#### **（一）本次募集资金主要投向科技创新领域**

公司所在集成电路封装测试行业属于高新技术产业和战略性新兴产业，建设自主可控的集成电路产业体系是我国推进战略性新兴产业规模化发展的重点任务之一。根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版），公司主要封装技术属于“1.3 电子核心产业”之“1.3.1 集成电路”中的“集成电路芯片封装，采用 SiP、MCP、MCM、CSP、WLP、BGA、FlipChip、TSV 等技

术的集成电路封装”，根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.4 集成电路制造业”。公司作为集成电路高端先进封装测试服务商，主营业务属于科技创新领域。

本次募投项目聚焦公司集成电路高端先进封装测试主营业务，通过引入先进的封装设备、导入新的封装制程，进一步提高集成电路先进封装测试全制程生产能力，提升产品的品质和管理效率，增强公司产品的市场竞争能力，满足公司研发布局与业务扩张需求，持续强化公司的科创实力。

## （二）本次募投项目促进公司科技创新水平提升

集成电路封装测试行业属于资金密集型行业，随着终端市场的快速发展和行业技术的迭代革新，需持续提升技术水平、丰富产品布局以持续保持竞争优势。公司通过持续稳定的研发投入，积累了深厚的技术及人才储备，掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术和大量工艺经验。通过本次募投项目的实施，公司可以进一步巩固市场地位，强化在全流程封测的技术突破和产业布局，拓宽公司产品下游应用市场，为公司的可持续发展提供保障。

## 四、结论

综上所述，公司认为：公司本次发行募集资金投向属于科技创新领域，符合未来公司整体发展方向，有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定的要求。

合肥顾中科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日